

ソルダバンピングワイヤ Solder Bumping Wire

特徴 Features

ソルダバンピングワイヤはワイヤボンディング装置を用いてはんだバンパを形成することができます。

The solder bumping wire can be available for forming solder bumps by using a wire-bonding machine.

用途 Applications

- ◆200ピン以下の半導体装置のバンパ形成に適します。
- ◆Al電極上に直接はんだバンパを形成することができます。
- ◆小型チップのダイボンダ。
- ◆チップ部品の基板搭載時の微小はんだ供給。
- ◆凹凸のある基板表面へのはんだ供給。

- ◆It's suitable for forming bumps in semiconductor equipment with less than 200 pins.
- ◆It's possible to directly form bumps on an Aluminum electrode.
- ◆Die-bonding of inside micro parts.
- ◆Slight solder supply at assembly with chip on the PCB.
- ◆Supply of the solder to uneven surface of the PCB.

仕様 Specification

Type	Base metal mass%	Solidus temperature °C	Reflow temperature °C	Wire diameter μm	Bump form		Necessity of BLM※2 for bump formation	Flux
					Ball ※1	Wedge		
SB28H	Pb-10Sn	281	330	40-100	○	○	Required	HVF013M HVF014R
SB28S	Pb-10Sn	281	330	100-150	-	○	Required	
SBA-12	Sn-1Ag	220	250	35-70	○	-	Not Required	
SB18	Pb-61Sn	183	230	35-70	○	○	Required	
SBW-628-040	Sn-3.5Ag	219	250	40	○	○	Not Required	

※1:Ball formation gas Ar+H₂ ※2:Ball Limiting Metallization 下地金属

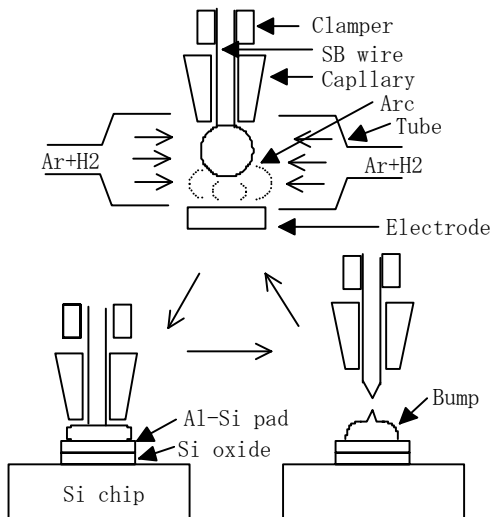


Fig.1 Ball bonding

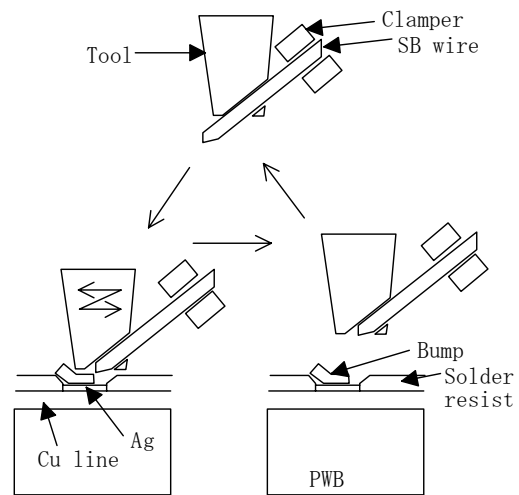


Fig.2 Wedge bonding

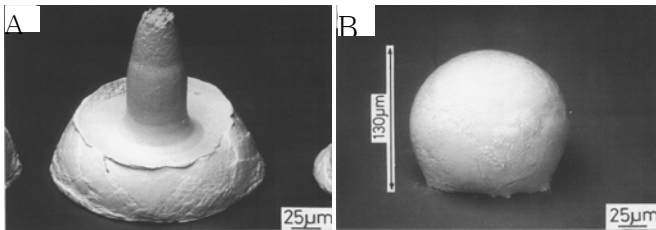


Fig.3 Bump form /A:as bonded /B:after reflow

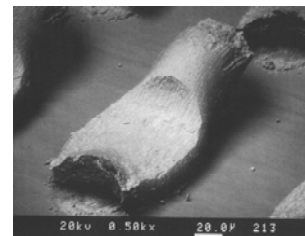


Fig.4 Bump form /as bonded

内橋エステック株式会社

Uchihashi

〒538-0041 大阪市鶴見区今津北 2-9-14

URL <http://www.uchihashi.co.jp/>

大阪営業 TEL 06-6962-6666 FAX 06-6962-6669

東京営業 TEL 03-3989-1481 FAX 03-3989-1487

osk-sales@uchihashi.co.jp

tky-sales@uchihashi.co.jp